

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и Дата

Инв. № подл.

ИУ 4.11.03.03.19.05.02.04.005 СБ

Установка разъема XS1

Установка разъема XS2

Установка стабилитрона VD5

Установка элек. конденсаторов C1, C2, C4

Установка конденсаторов C3

Установка диода VD2

1. Размеры для справок

2. Печатные проводники не показаны.

3. Обозначение элементов показаны условно.

4. Монтаж выполнить согласно схеме ИУ 4.11.03.03.19.05.02.003 ЭЗ

5. Установку новестных элементов производить по ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 класс В , припой п.5, располагая их симметрично относительно контактных площадок. Для компонента типа "чип" допускается выход компонентов за пределы контактной площадки не более 0,05 мм.

6. Минимальный допустимый зазор между соседними компонентами поверхностного монтажа (включая зоны паяк, выводов и торцы компонентов) должен быть не менее 0,2 мм.

7. Установка выводных разъемов осуществлять по ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010.

8. Пайку КМО производить согласно ГОСТ 23592-96 , припой п.5 .

9. ПОС -61 ГОСТ 21930-76.

10. После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто -бензиновой смесью ГОСТ 18300-87 .

11. Контроль паяных соединений производить визуально - оптическим методом по ГОСТ 24715-81 .

12. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070 .015 .

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---------|------|----------------------------------|--|----------|---------|
| | | | | | ИУ 4.11.03.03.19.05.02.04.005 СБ | | | |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Блок питания Сборочный чертёж | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Исмаилов А.К | | | | | | 0,15 | 2:1 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т.контр. | | | | | | МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ 4 Группа ИУ 4-52 Б | | |
| Реценз. | | | | | | | | |
| Н.контр. | Сергеева М.Д. | | | | | | | |
| Утв. | Семенцов С.Г. | | | | | | | |

Копировал Формат А3

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

Копировал Формат А3